



电子元器件：半导体景气高涨 8 月设备出货金额延续高成长



二季度全球智能手机出货量有所回升，国内 5G 手机出货渗透率维持七成以上：根据 IDC 的数据，2021 年第二季度全球智能手机出货量 3.13 亿台，同比增长 13.2%。根据中国信息通信院的数据，2021 年 8 月国内 5G 手机出货量 1768.8 万台，同比增长 9.39%，5G 手机渗透率为 76.6%。

在经历了 2020 年的低谷时期以后，随着 5G 时代的到来，全球智能手机出货量有所回升。5G 手机渗透率自 2021 年以来基本都在七成以上，随着 5G 技术的发展和应用，预计智能手机行业出货量将继续增长，5G 手机的渗透率也将进一步提升。

行业景气高涨，8 月半导体设备出货金额维持高增长：根据 SEMI 以及日本半导体制造装置协会的数据，2021 年 8 月北美半导体设备出货金额 36.50 亿美元，同比增长 37.60%，环比下降 5.40%；日本半导体设备出货额 2457.19 亿日元，同比增长 30.42%，环比增长 2.07%。总体来看 8 月北美和日本半导体设备出货金额维持 30%以上的同比增速，晶圆厂在行业高景气的推动下，纷纷扩大资本开支，带动上游设备需求大增。

半导体设备招投标情况：上周（2021.09.13-2021.09.26）半导体设备招投标情况：根据机电产品招标投标电子交易平台：长江存储上周新增 7 台招标设备和 18 台中标设备，上海积塔上周新增 1 台招标设备和 5 台中标设备，中芯绍兴上周新增 1 台招标设备和 18 台中标设备，华虹无锡上周新增 1 台中标设备，上海华力上周共新增 3 台招标设备和 2 台中标设备。国产设备厂商方面，屹唐半导体中标 1 台干法刻蚀设备，成都莱普科技中

标 2 台退火设备，华海清科中标 2 台抛光机（CMP）设备，北方华创中标一台场氧化立式炉管，中科飞测中标 2 台晶圆缺陷自动检测设备，上海微电子中标 3 台激光热退火机。

投资建议：推荐国内高性能 ADC 龙头上海贝岭、IC 离子注入设备龙头万业企业、清洗设备龙头至纯科技、半导体硅片领先厂商立昂微。

风险提示：下游需求不及预期；国产替代不及预期；疫情影响持续风险

关键词: 5G 疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27284

